

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke

Band: 64 (1973)

Heft: 16

Artikel: Informationstagung "Neuartige elektrische Verbindungsverfahren" am 23. Mai 1973 in Zürich : Einführung

Autor: Fornallaz, P.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-915583>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BULLETIN

DES SCHWEIZERISCHEN ELEKTROTECHNISCHEN VEREINS

Gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV)
und des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)

Informationstagung «Neuartige elektrische Verbindungsverfahren»

am 23. Mai 1973 in Zürich

Einführung

Von P. Fornallaz, Tagungsleiter

621.791.7 : 061.3

Aus der grossen Palette der Verbindungsverfahren sollen einige besonders interessante Schweißverfahren zur Darstellung kommen. Die Auswahl wurde nach folgenden Kriterien getroffen:

a) Es sollen einerseits nichtkonventionelle Verfahren und andererseits besonders interessante Weiterentwicklungen von konventionellen Verfahren behandelt werden.

b) Es sollen ferner diejenigen Verfahren bevorzugt werden, welche für den Kleinapparatebau von besonderer Bedeutung sind. Die vielfältigen Kontaktierungsverfahren der Mikroelektronik können dabei nur berührt werden.

Diese Informationstagung richtet sich an einen Zuhörerkreis von Anwendern dieser Schweißverfahren. Die wissenschaftlichen und technischen Grundlagen der besprochenen Verfahren werden deshalb nur so weit zur Darstellung kommen, als es für das Verständnis der Schweissergebnisse notwendig ist. Dagegen sollen die technischen Einsatzmöglichkeiten, d. h. die technischen Vorzüge im Einsatzbereich und die Grenzen dieses Einsatzbereiches, ausführlich dargelegt und die wirtschaftlichen Grenzen der Verfahren hervorgehoben werden. Zu diesem Zweck wurde ein einheitliches Kalkulationsschema ausgearbeitet und die Referenten gebeten,

ihren Wirtschaftlichkeitsüberlegungen die Annahmen dieses Schemas zugrunde zu legen.

In Tabelle I wurde versucht, die verschiedenen Schweißverfahren übersichtlich zusammenzustellen. Man unterscheidet Schmelzschweißverfahren und Preßschweißverfahren. Die erste Gruppe umfasst alle Verfahren, bei welchen die Verbindung durch Erzeugung eines örtlichen Schmelzflusses und ohne Druck zustande kommt. In diese Gruppe gehören das autogene Schweißen und die verschiedenen Lichtbogen-Schweißverfahren, die an der Tagung nicht zur Sprache kommen. Dagegen sollen in dieser Gruppe das Mikroplasmenschweißen, das Laserimpulsschweißen und das Elektronenstrahlenschweißen behandelt werden. Charakteristisch für diese drei Verfahren ist die hohe Leistungsdichte, die an der Schweißstelle erreicht wird. Während beim Autogenschweißen und beim Lichtbogenschweißen Leistungsdichten im Bereich von $10^3 \dots 10^5 \text{ W/cm}^2$ erzeugt werden, erlauben die drei anderen Verfahren wesentlich höhere Leistungsdichten von $10^6 \dots 10^9 \text{ W/cm}^2$. Unter besondere Bedingungen sind beim Laserimpulsschweißen sogar Leistungsdichten von 10^{13} W/cm^2 erreicht worden.

Bei der ersten Gruppe von Preßschweißverfahren wird zusätzlich zum Elektrodendruck Schweißwärme durch Funkenprung, durch eine Gasflamme oder in Form von Joulescher Wärme erzeugt. Je nach der Leistungsdichte wird an der Schweißstelle die Schmelztemperatur des Werkstoffes überschritten, oder aber man bleibt absichtlich unter dieser Schmelztemperatur, um Rekristallisations-Erscheinungen zu vermeiden. In der Feintechnik wird eine grosse Anzahl von Schweißverfahren angewendet, die als Sonderformen oder Kombinationen des Impulsschweißens und des Widerstandsschweißens bezeichnet werden müssen. Man denke beispielsweise an das Feinpunktschweißen, das Ultrapulsschweißen, das Buckelschweißen, das Bolzenschweißen oder das Mikroschweißen. Einige besonders interessante Weiterentwicklungen auf diesem Gebiet sollen deshalb dargelegt werden.

Bei der zweiten Gruppe der Preßschweißverfahren wird Wärme nur sekundär als Folge von Reibung und plastischer Deformation erzeugt. Im Kleinapparatebau ist das Ultraschallschweißen von besonderer Bedeutung für die Verbindung von schwer verschweißbaren metallischen Werkstoffen und von Kunststoffpartnern.

Adresse des Autors:

Prof. P. Fornallaz, Inhaber des Lehrstuhles für Feintechnik an der ETH, Leonhardstrasse 27, 8001 Zürich.